

---

# 2023年12月期 決算説明会

---

2024年2月14日（水）

 **メック株式会社**

証券CODE:4971

<https://www.mec-co.com/>

**1** 売上：14,020百万円（前期比 14.1%減）  
営業利益：2,492百万円（前期比 37.7%減）

**2** 為替の影響は前期比  
売上：305百万円増、営業利益：111百万円増

**3** 薬品売上：13,764百万円（前期比 14.2%減）  
出荷量：35,398t（前期比 21.3%減）

**4** 主要製品売上は前期比  
EXE 3.1%増、V-Bond 5.6%減、CZ 16.3%減、SF 37.7%減

# 為替レート

(単位：円)

	期初想定	2023Q4	2022Q4	2023Q3
N T D	4.37	4.52	4.40	4.48
R M B	19.33	19.81	19.39	19.66
H K D	16.34	17.96	16.70	17.73
T H B	3.69	4.04	3.73	4.01
E U R	136.04	152.27	137.93	150.22
U S D	128.03	140.55	130.78	138.87

- 海外現地法人は、基本的に現地通貨建てでの取引であり、連結会計で円換算する際に、円／現地通貨レートの影響を受ける。
- いずれも、期中平均レートを採用。
- 当社の主要外国通貨は、台湾ドル（NTD）、中国人民元（RMB）。
- 各通貨に対して想定レートから0.1円変動する場合の影響額は次のとおり。

NTD：（売上）57百万円（営業利益）33百万円

RMB：（売上）22百万円（営業利益）10百万円

\*いずれも、当期累計実績

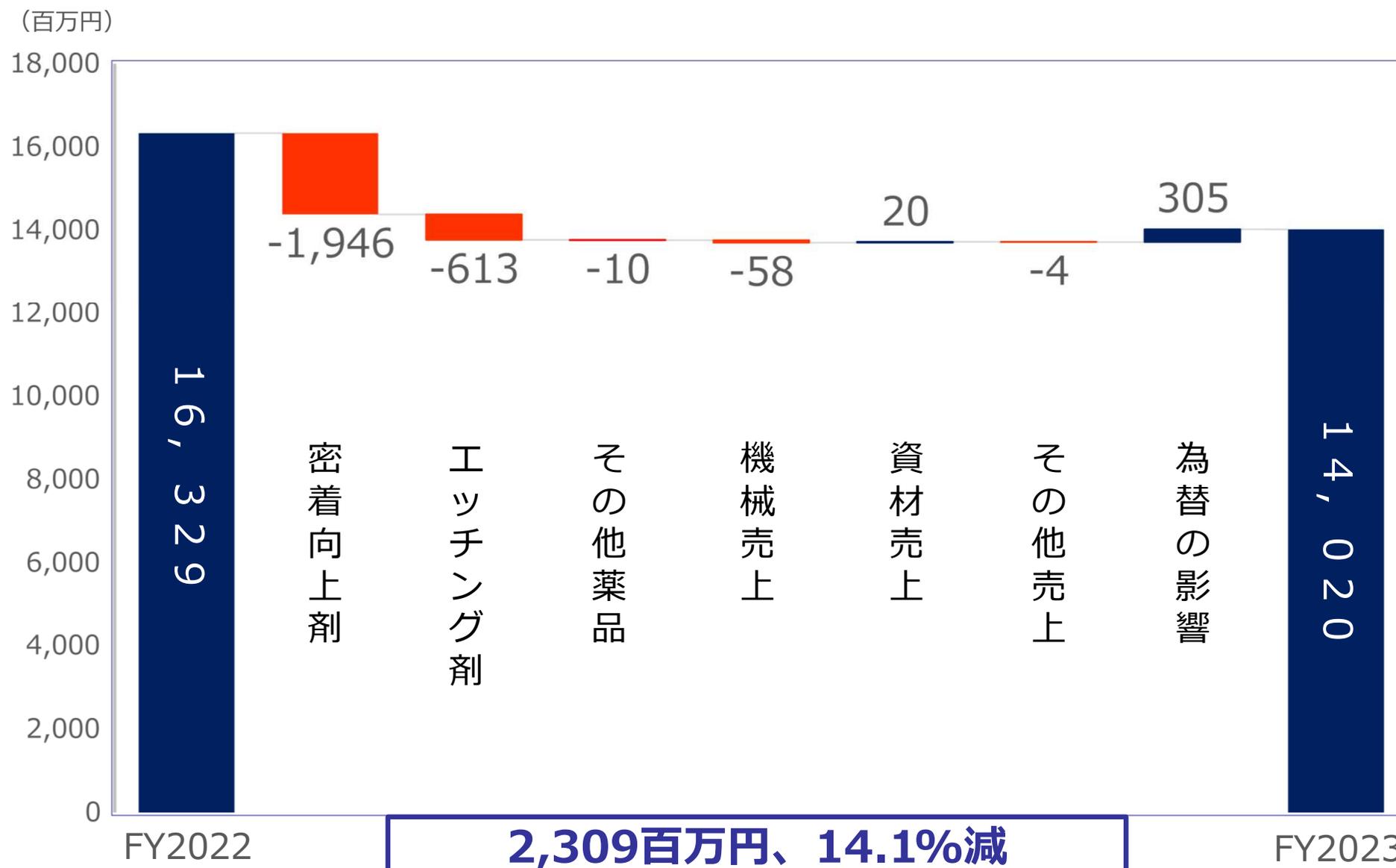
# 2023年12月期 業績概要



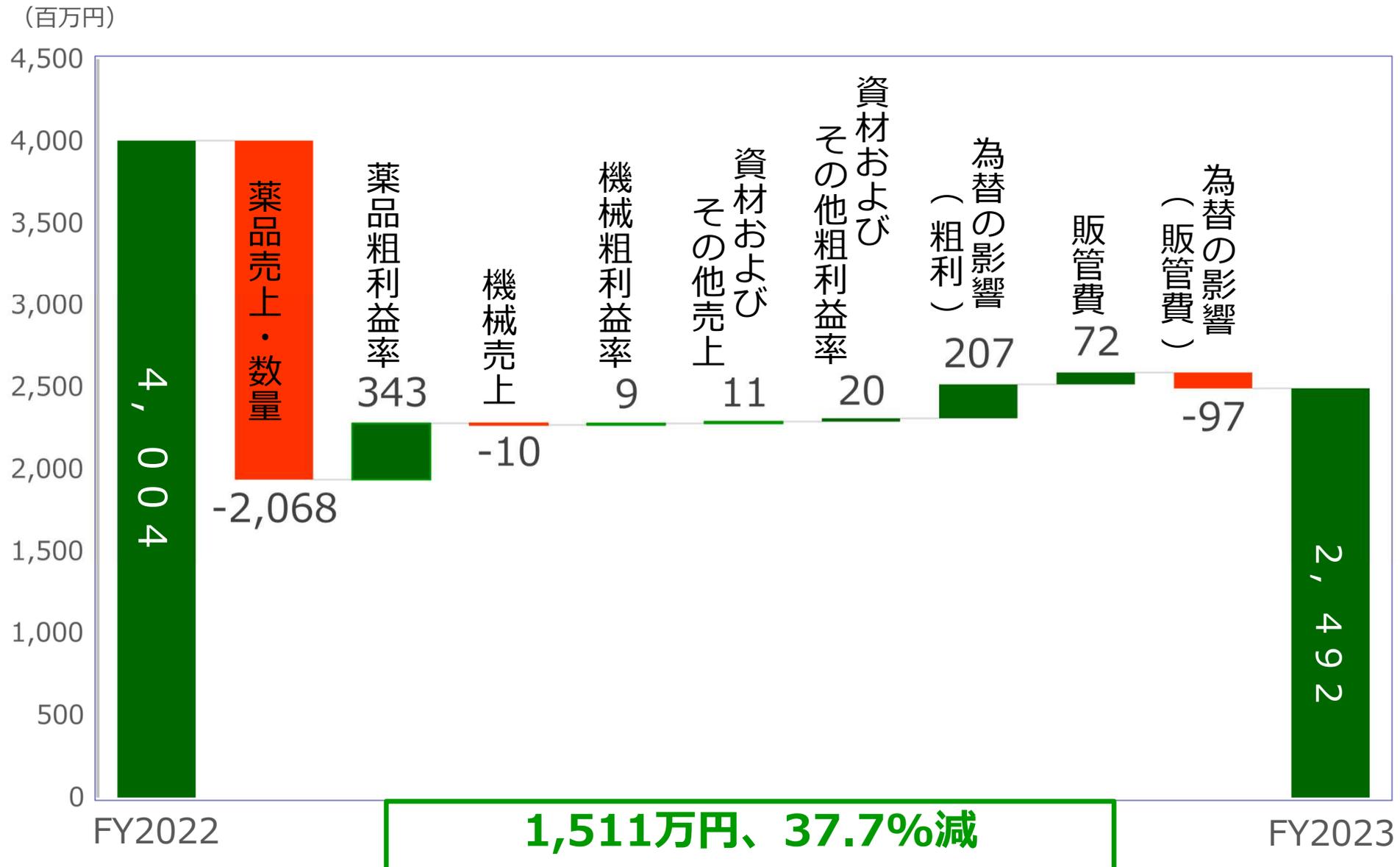
(単位：百万円)

項目	FY2022 (実績)	FY2023 (実績)	FY2023	
			前期比	
売上高	16,329	14,020	△2,309	△14.1%
薬品売上高	16,042	13,764	△2,277	△14.2%
売上総利益	9,803	8,316	△1,487	△15.2%
売上総利益率	60.0%	59.3%	△0.7ppt	-
販売費及び一般管理費	5,799	5,824	24	0.4%
売上高比率	35.5%	41.5%	6.0ppt	-
営業利益	4,004	2,492	△1,511	△37.7%
営業利益率	24.5%	17.8%	△6.7ppt	-
経常利益	4,246	2,683	△1,563	△36.8%
経常利益率	26.0%	19.1%	△6.9ppt	-
税引前当期利益	4,224	3,219	△1,005	-
当期純利益	3,064	2,304	△759	△24.8%
EBITDA	4,989	3,993	△996	△20.0%
1株当たり当期利益 (円)	161.22	122.29	-	-
1株当たり配当金 (円)	45.00	45.00	-	-
ROE	13.8%	9.6%	△4.2ppt	-

# 連結売上高前期比分析



# 連結営業利益前期比分析



# 連結貸借対照表要旨 資産

(百万円)

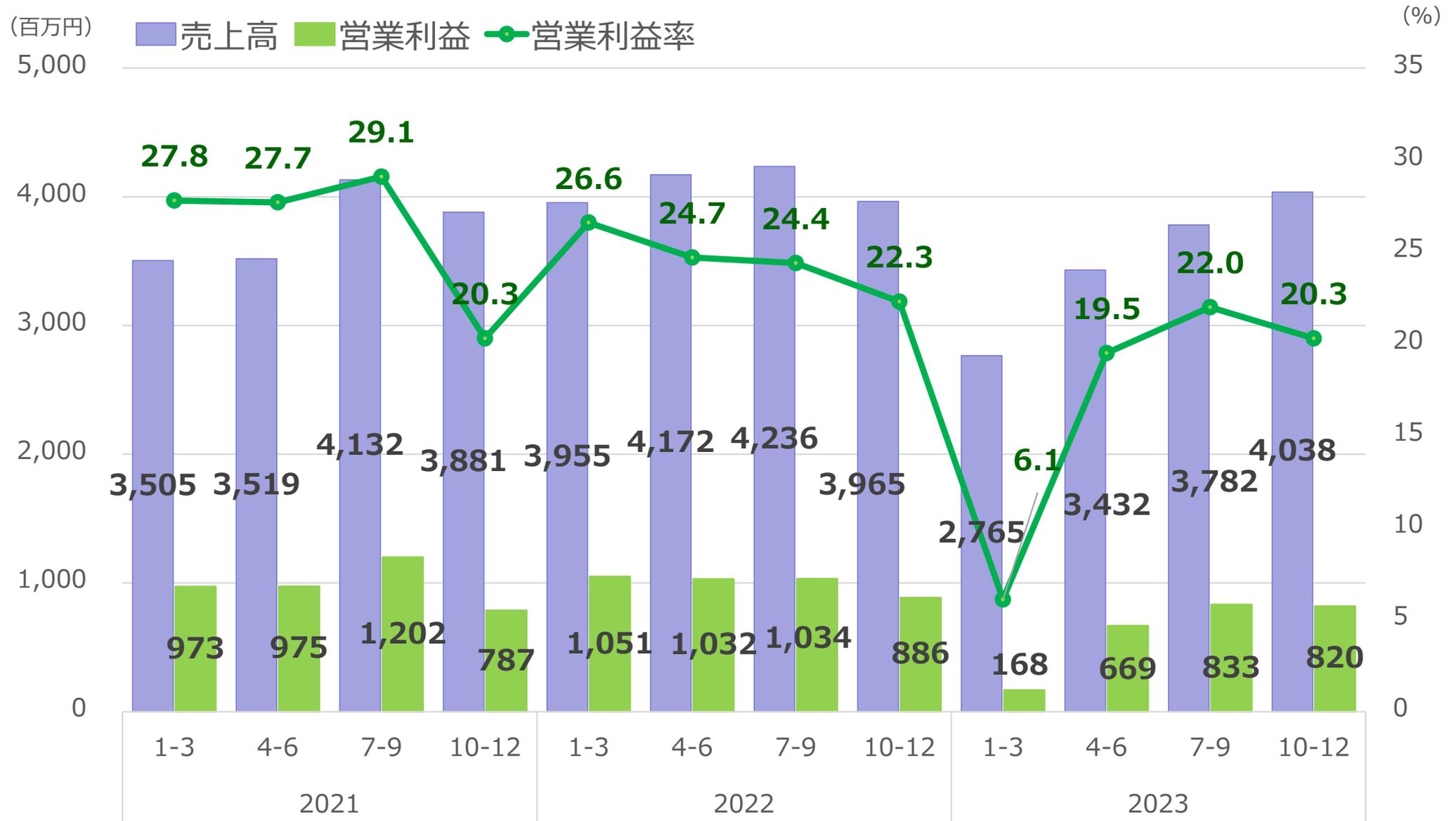
	FY2022	FY2023	特記事項
流動資産	15,987	15,492	新工場用地の購入等
固定資産	11,512	13,172	－
有形固定資産	8,959	9,820	新工場用地の取得、西宮工場の売却等
無形固定資産	146	160	－
投資その他の資産	2,405	3,191	株価上昇等
資産合計	27,499	28,665	－

# 連結貸借対照表要旨 負債・純資産

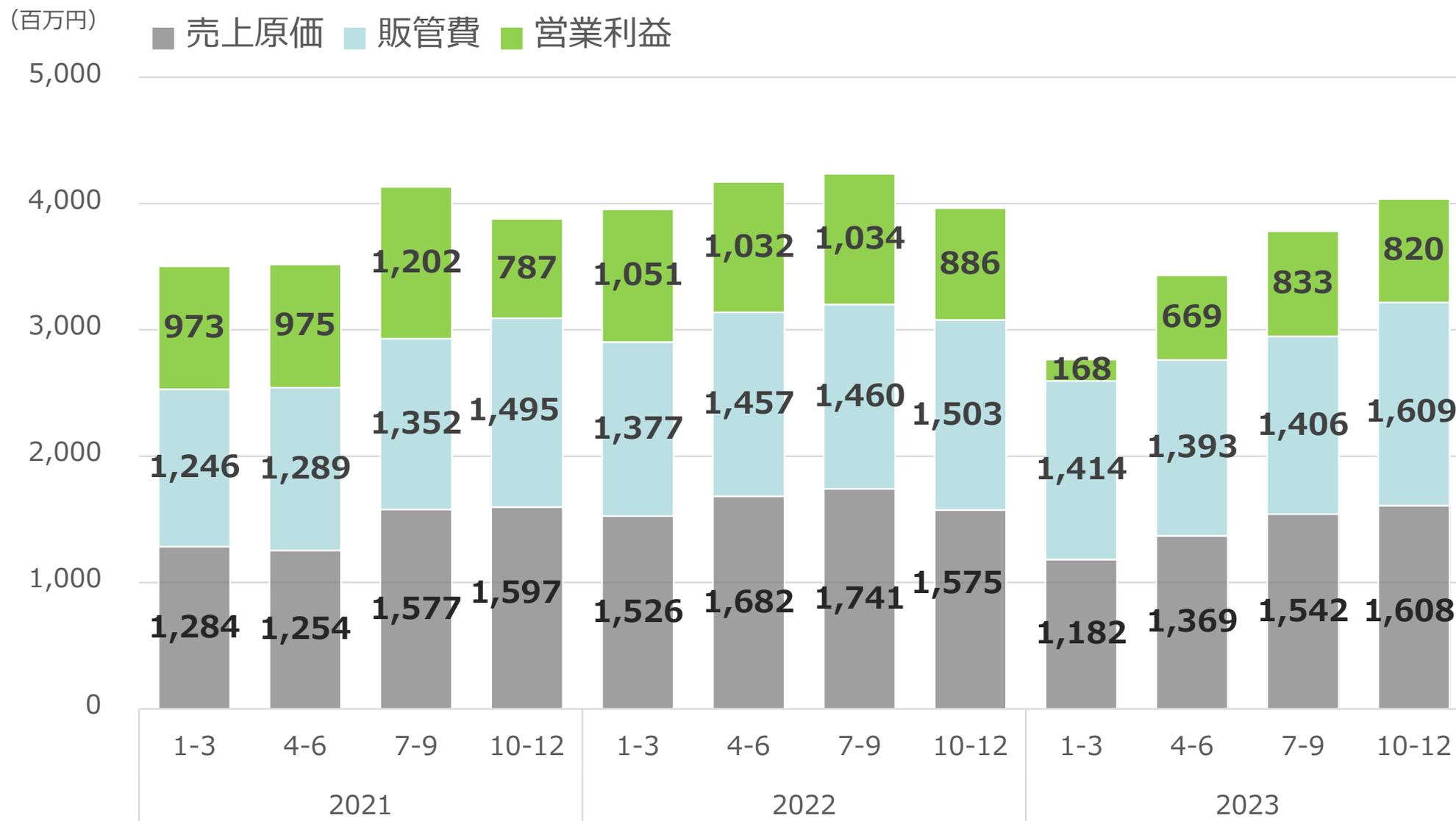
(百万円)

	FY2022	FY2023	特記事項
流動負債	3,562	2,872	電子記録債務の減少等
固定負債	611	1,015	－
負債合計	4,173	3,887	－
株主資本	21,278	21,826	利益剰余金の増加等
その他の 包括利益累計額	2,047	2,951	為替換算調整勘定や有価証券評価差額金の増加等
純資産合計	23,325	24,777	－
負債純資産合計	27,499	28,665	－

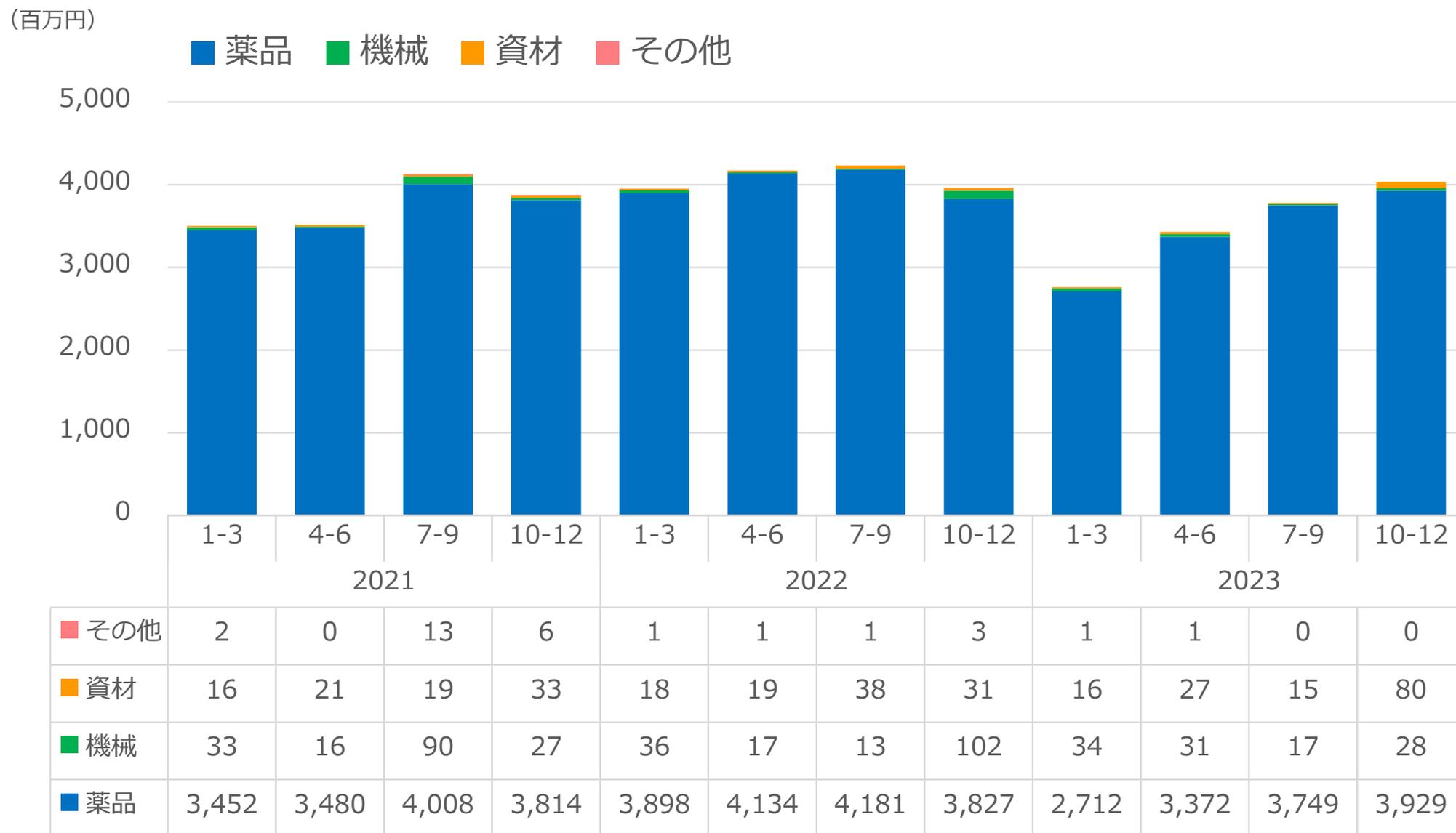
# 連結売上高と営業利益/営業利益率



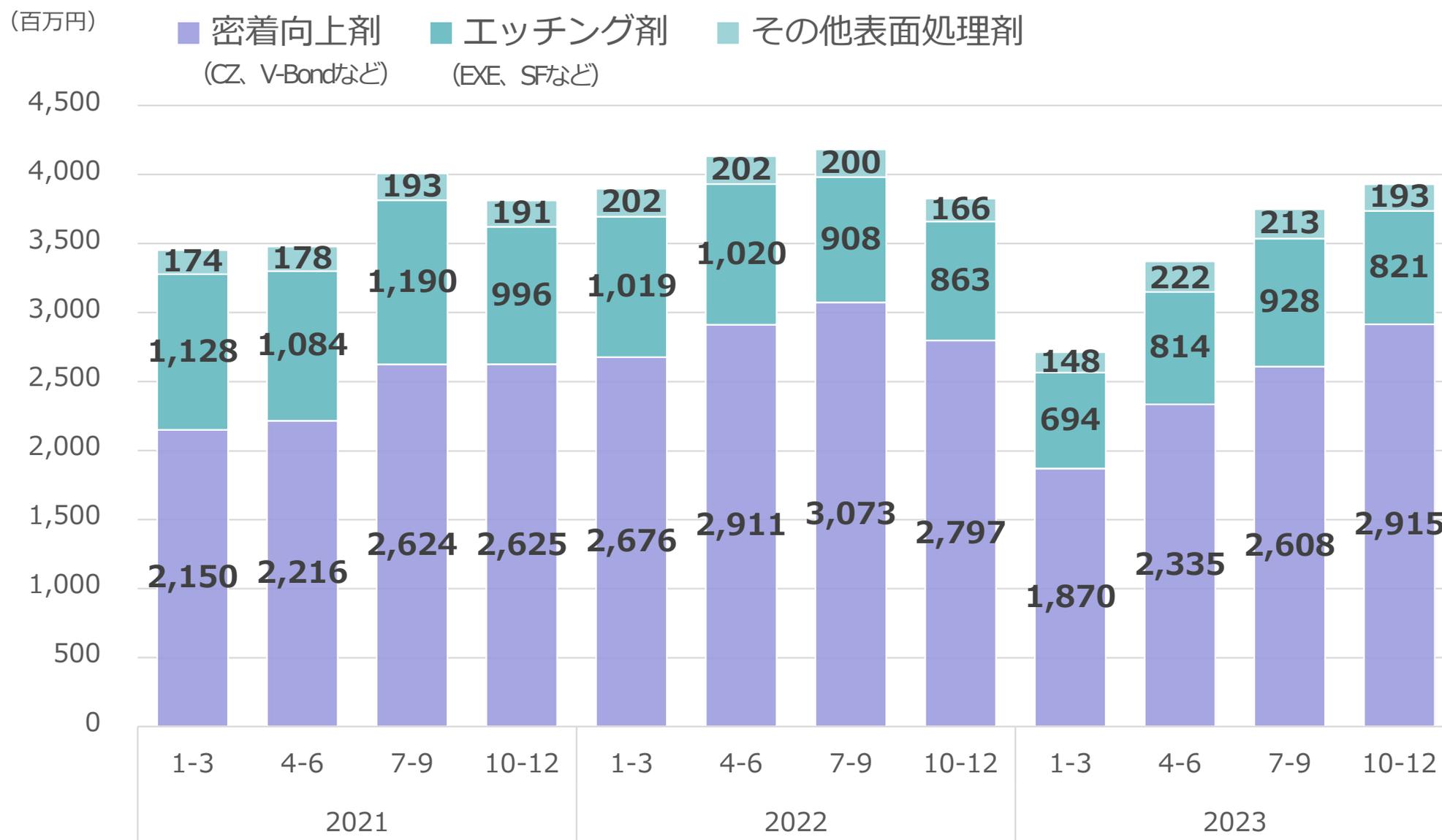
# 連結損益構造



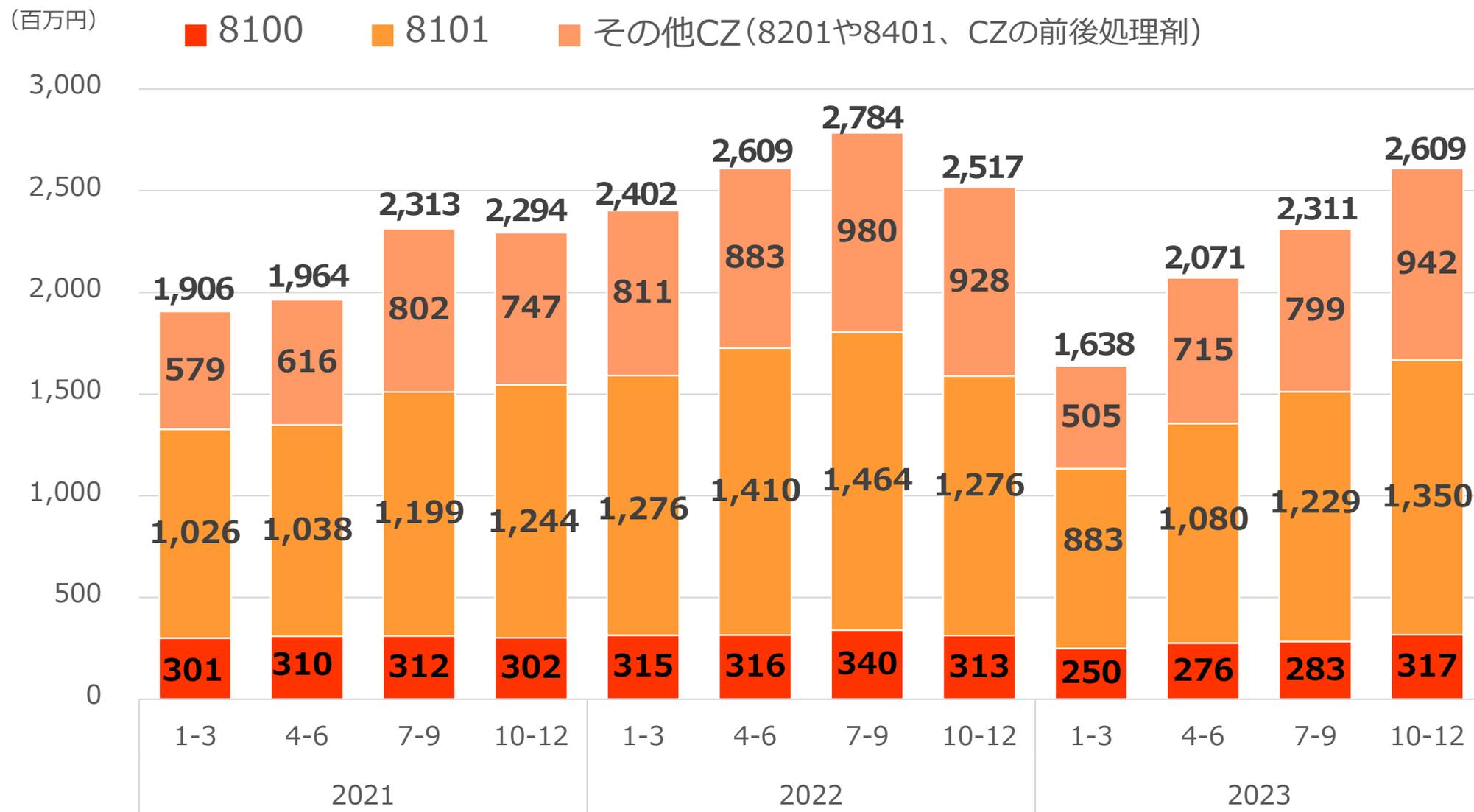
# 連結品種別売上高



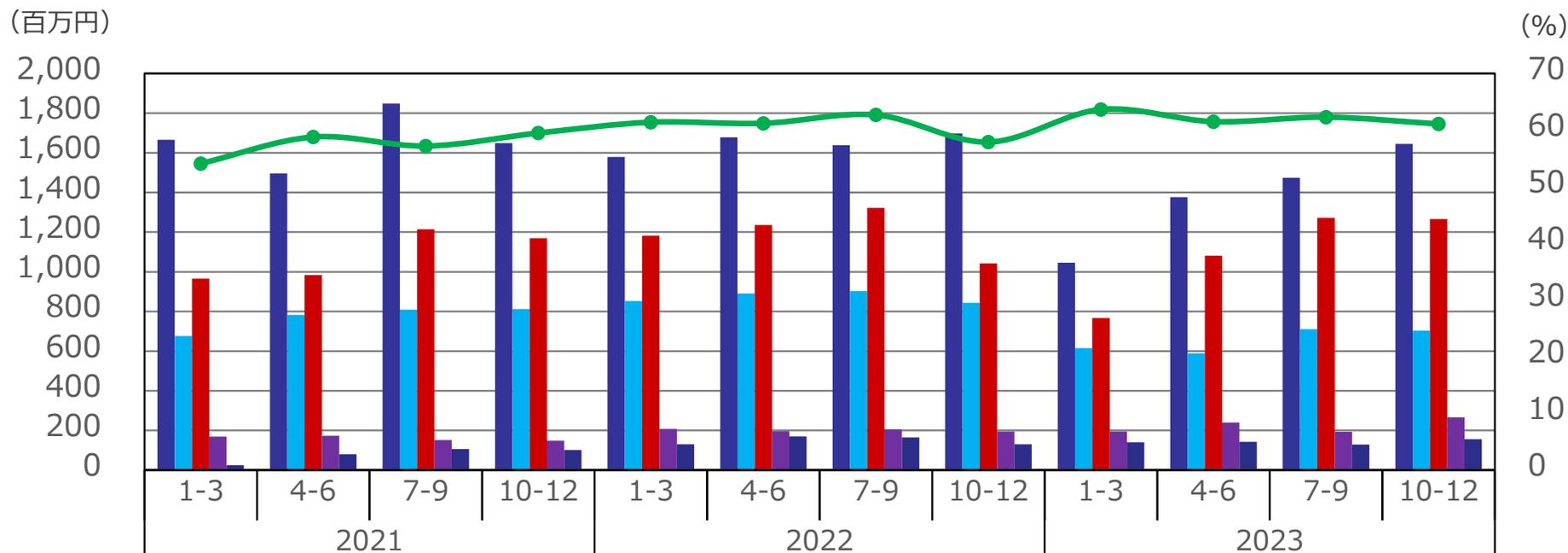
# 連結薬品別売上高



# CZシリーズ売上高



# 地域セグメント別売上高

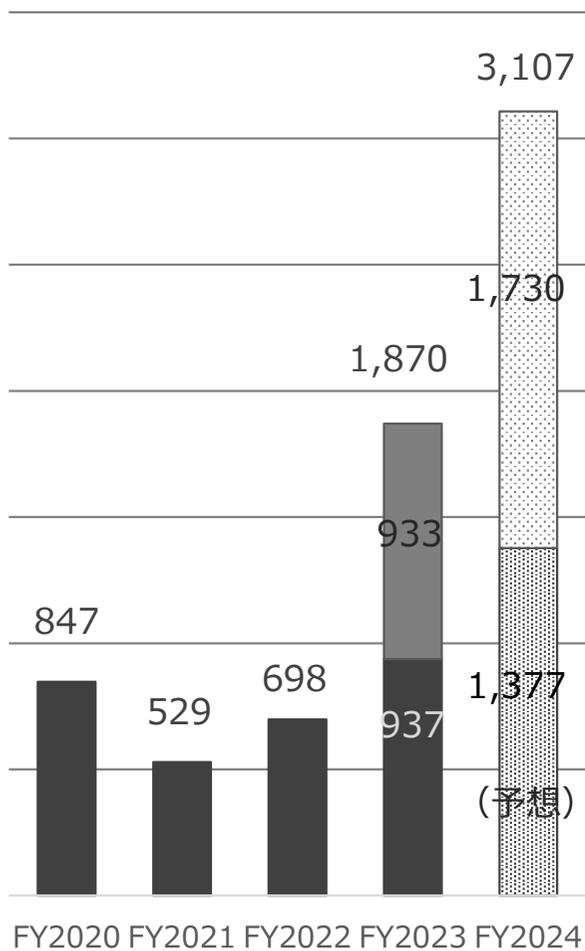


■ 日本	1,666	1,496	1,849	1,649	1,579	1,678	1,638	1,698	1,046	1,376	1,474	1,645
■ 台湾	676	783	809	812	853	891	903	844	615	589	711	703
■ 中国	966	984	1,215	1,169	1,182	1,236	1,322	1,043	767	1,081	1,272	1,266
■ 欧州	169	173	152	148	208	196	205	195	195	240	193	266
■ タイ	25	80	106	101	130	170	165	130	140	143	129	156
● 海外売上高比率	54.1	58.8	57.2	59.5	61.4	61.2	62.7	57.9	63.7	61.5	62.3	61.1

・ 当社薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合の比率は79.7% (前年同一期間は77.4%)。

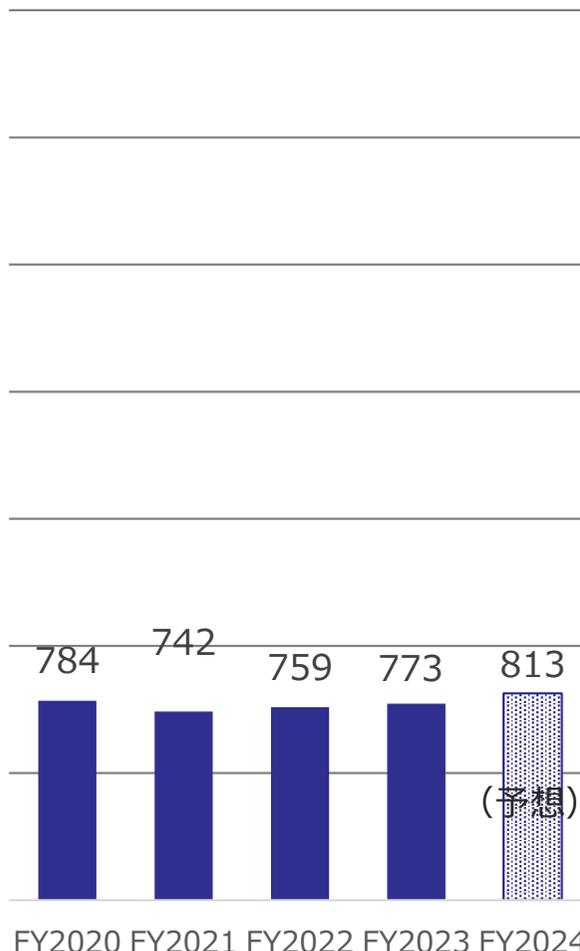
# 設備投資額と減価償却費、研究開発費

設備投資額 (百万円)



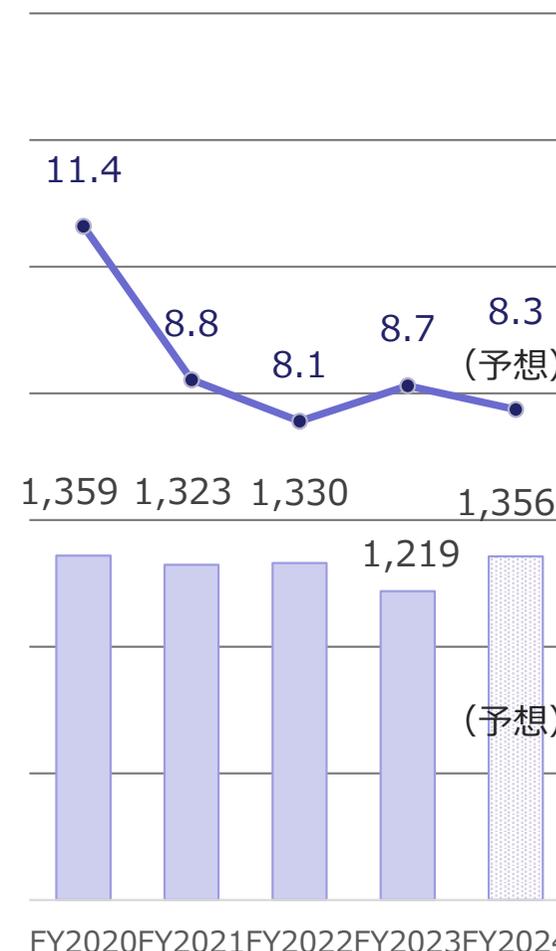
北九州工場に係る設備投資額  
 ■ FY2023 933百万円  
 □ FY2024 1,730百万円 (予想)

減価償却費 (百万円)

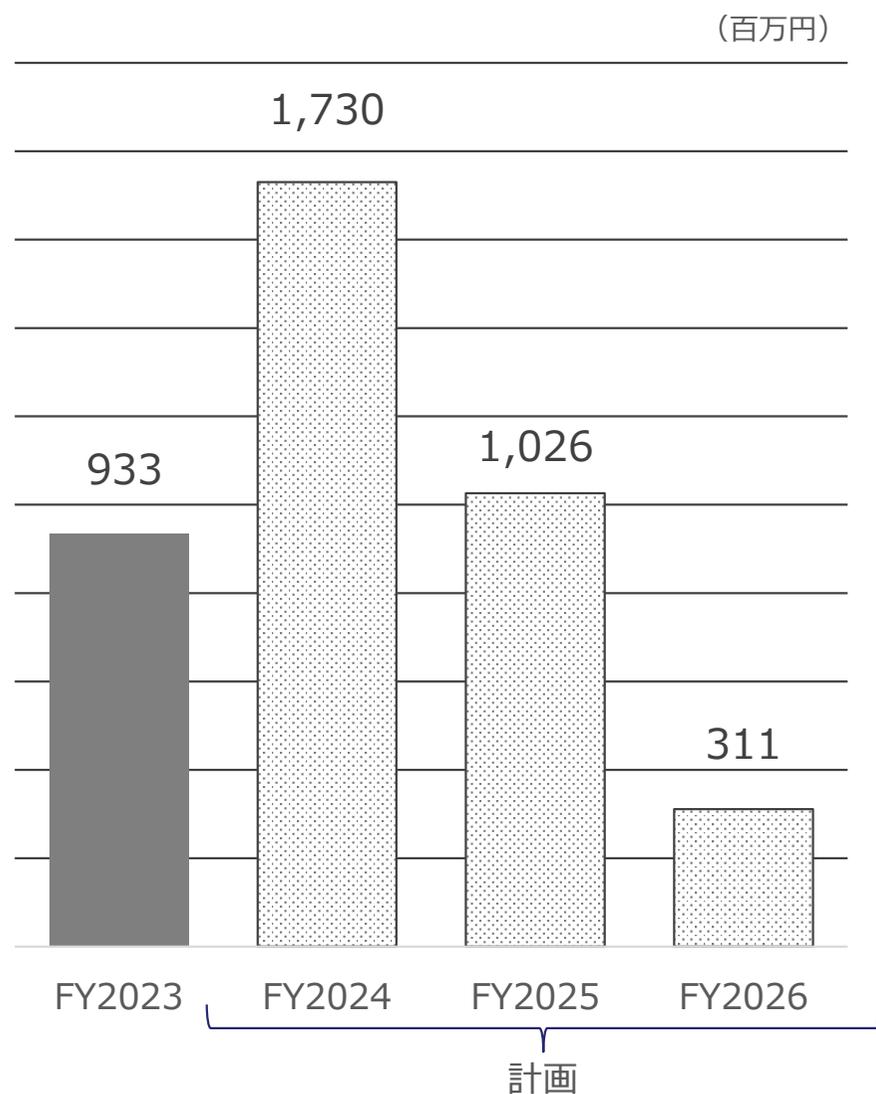


北九州工場に係る減価償却費は稼働後、1.5～2億円/年程度となる見込み

研究開発費と (百万円)  
売上高研究開発費比率 (%)



# 北九州工場（仮称）設備投資計画



北九州工場設備投資計画に係る減価償却費は稼働後、1.5～2億円/年程度となる見込み

## 北九州工場（仮称）



- ✓ 福岡県北九州市若松区
- ✓ 敷地面積 29,889m<sup>2</sup>
- ✓ 生産能力 約30,000t/年（予定）
- ✓ 総投資額 約40億円（土地取得費含む）
- ✓ 着工 2024年4月（予定）
- ✓ 稼働 2025年7月（予定）

# 今後の見通し

# 主要薬品用途と最終製品例

主要薬品	特徴	最終製品例
超粗化系密着向上剤 「CZシリーズ」	主にPKG基板向けの密着向上剤。 銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。	5G・データセンター等の通信インフラ、パソコン・スマートフォン・タブレットPC等の高機能デバイス等
多層電子基板向け密着向上剤 「V-Bondシリーズ」	多層基板向けの密着向上剤。 銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。PKGには使用されない。	スマートフォン・クルマ等
異方性エッチング 「EXEシリーズ」	COF基板向けのエッチング剤。 サブトラで微細配線形成ができる。	テレビ・パソコンのモニター等
選択エッチング銅除去剤 「SFシリーズ」	銅への選択性を持ったエッチング剤。	タブレットPC等

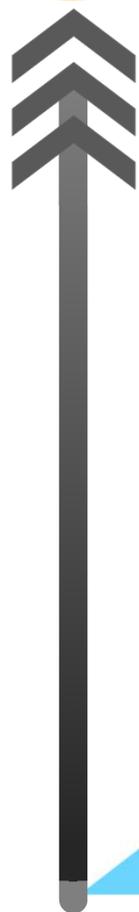
## ④ 事業環境

- ・短期的には、調整局面にある半導体市況や個人消費停滞等の影響を見込む。
- ・中長期的には、IoTやAI、5G、クルマの電動化やDX・GXの進展等の技術の広がりを背景に技術革新が進み、当社関連市場の拡大が進む。
- ・特に高まる半導体需要によるPKG基板の増加、超高密度化や超高周波化により関連する「CZシリーズ」、「化学密着向上剤」需要の伸びを見込む。

## ④ 主要製品

- CZ : 短期的には半導体市況停滞の影響受けるが、  
中長期的にはPKG基板の増加、大型・高多層化等により需要拡大。
- V-Bond : 短期的にはクルマは半導体不足が緩和され回復基調、  
一方、スマートフォンは買換サイクルの長期化の影響。
- EXE : 回復基調にあるが継続性は不透明。
- SF : スマートフォン向けは技術変化により減少し、  
タブレットPC向け需要は継続。

超高密度  
超高周波



最先端品 化学密着向上剤 APシリーズ

先端品

CZ-8401×化学密着向上剤 APシリーズ

CZ-8201

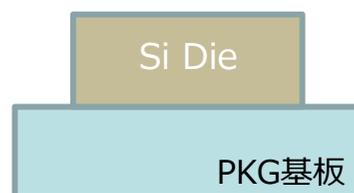
CZ-8101

汎用品

CZ-8100

通常のPKG

一つのPKGに  
一つの半導体



Chiplet

PKGを大きくし  
複数の半導体を搭載



EMIB

(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)



CoWoS

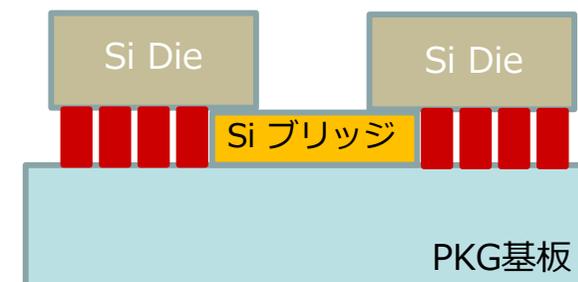
(Chip on Wafer on Substrate)



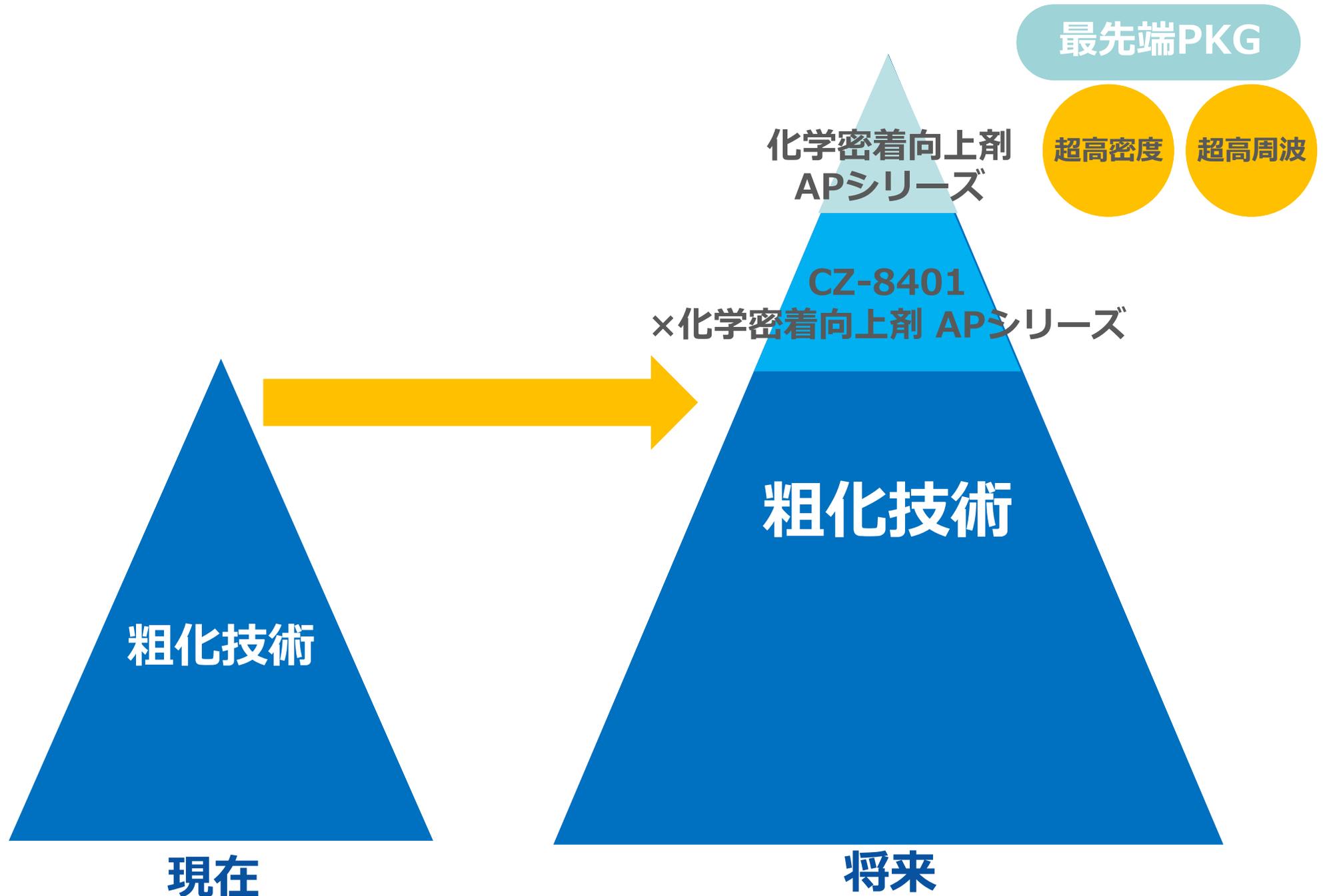
EFB

■ 銅ピラー

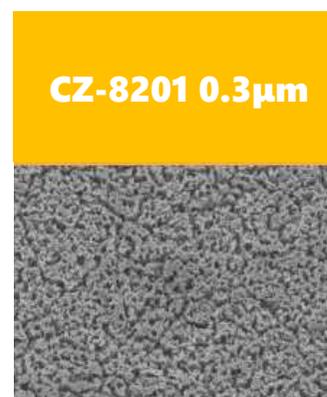
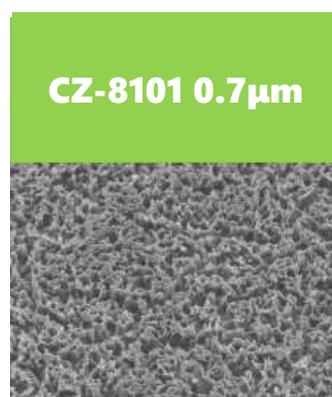
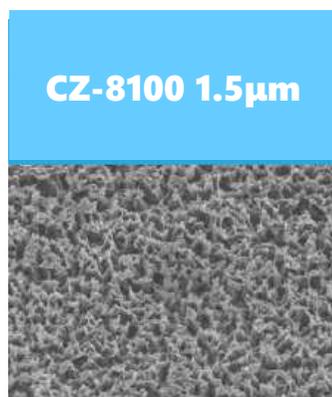
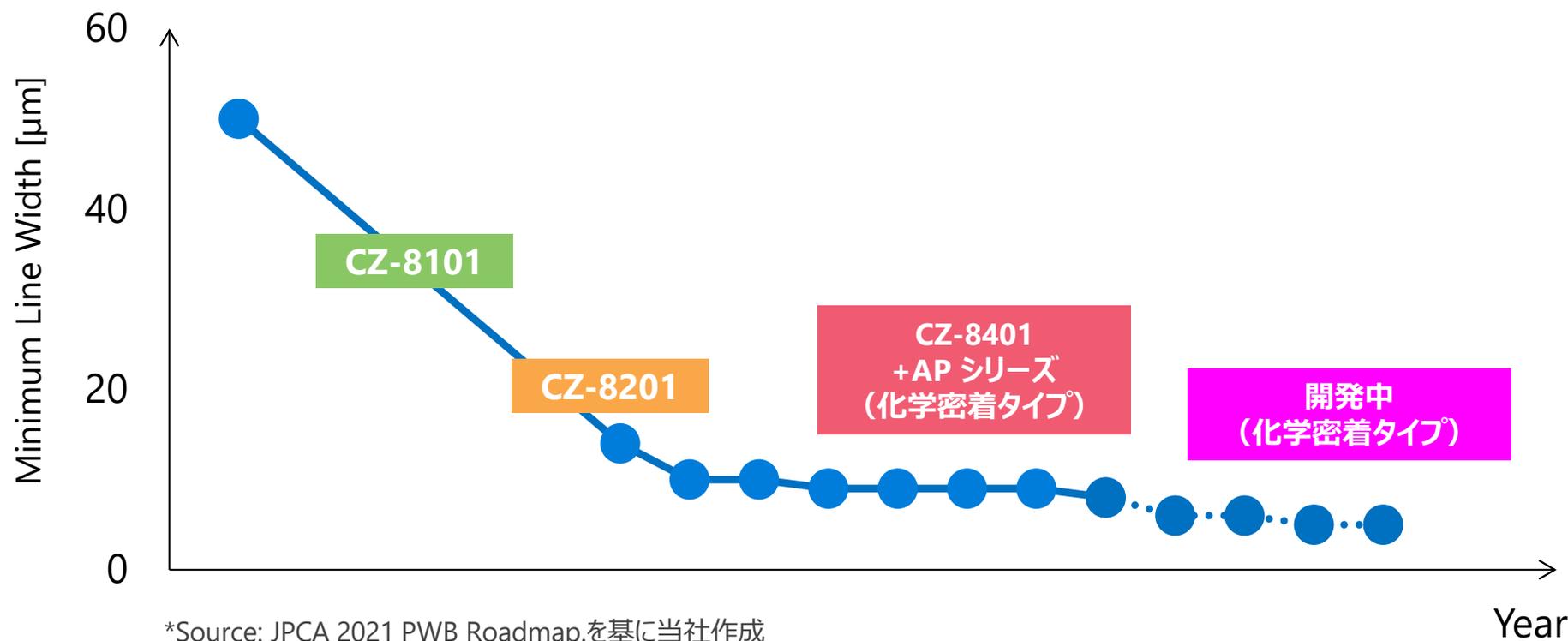
(Elevated Fanout Bridge)



PKG基板 ⇒ サイズ大型化、層数増加



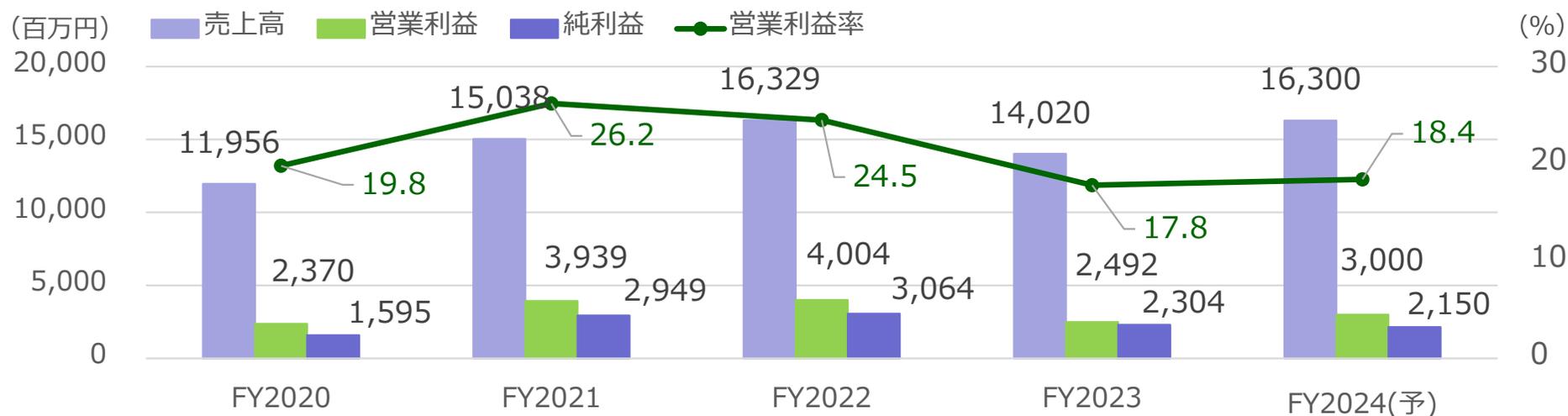
# CZシリーズのロードマップ



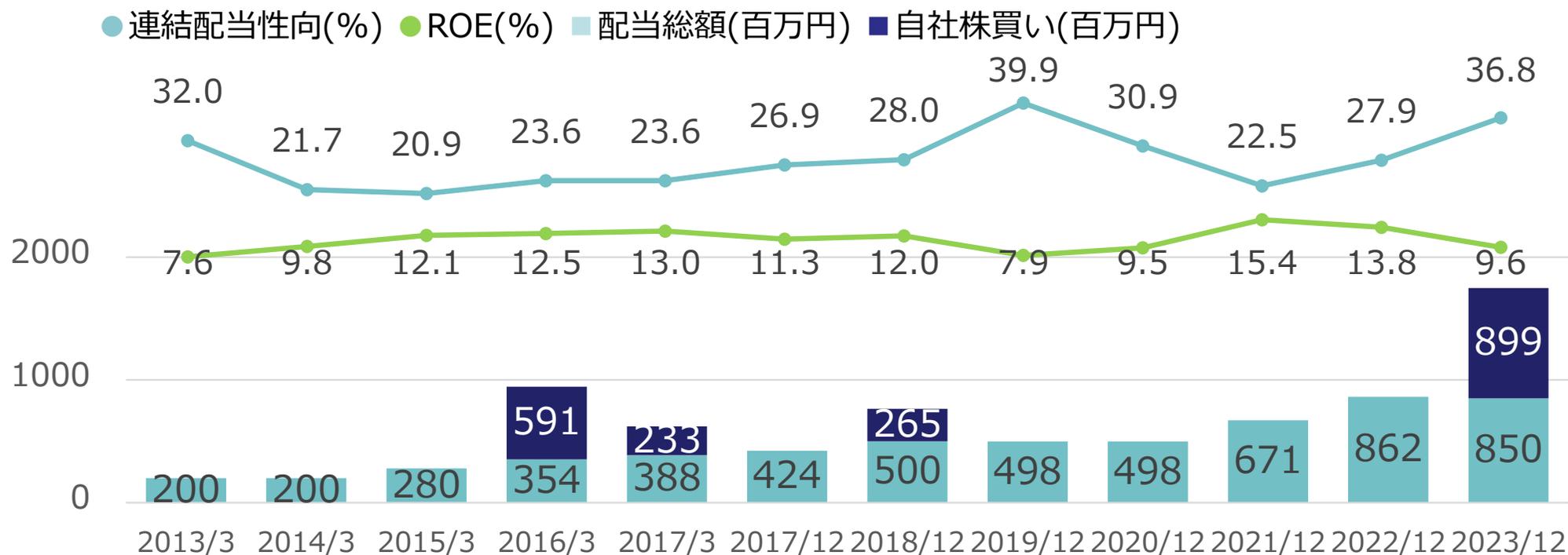
# 2024年12月期 連結業績予想

	FY2023				FY2024					
	1H		Full-year		1H			Full-year		
	百万円	利益率 (%)	百万円	利益率 (%)	百万円	利益率 (%)	YoY増減 (%)	百万円	利益率 (%)	YoY増減 (%)
売上高	6,198	-	14,020	-	<b>7,850</b>	-	26.6	<b>16,300</b>	-	16.3
営業利益	838	13.5	2,492	17.8	<b>1,300</b>	16.6	55.0	<b>3,000</b>	18.4	20.3
経常利益	1,003	16.2	2,683	19.1	<b>1,350</b>	17.2	34.6	<b>3,100</b>	19.0	15.5
純利益	1,076	17.4	2,304	16.4	<b>950</b>	12.1	△11.7	<b>2,150</b>	13.2	△6.7
1株当たり純利益(円)	56.79	-	122.29	-	<b>50.73</b>	-	-	<b>114.82</b>	-	-

\* FY2023上期に、西宮工場土地建物譲渡による特別利益（549百万円）が計上されております。



# 配当金総額と連結配当性向、ROEの推移



## 配当性向

中期目標 連結配当性向 30%

## ROE

2024年目標 10%以上

## 2024年12月期 配当予想

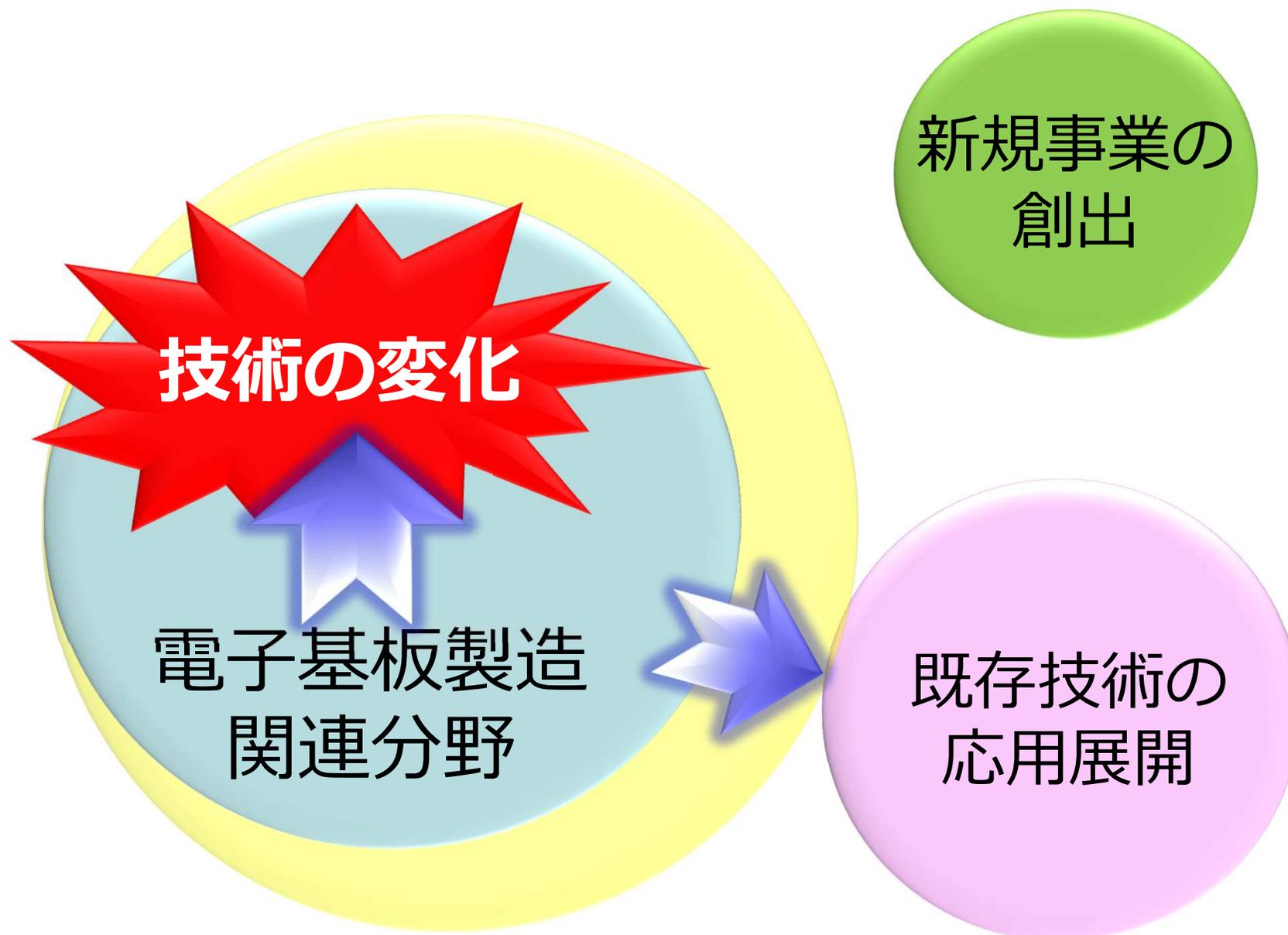
45.0円 (中間 20.0円、期末 25.0円 連結配当性向 39.2%)

\* 2023年12月期実績 : 45円 (中間20.0円、期末25.0円 連結配当性向 36.8%)

## 自己株式取得の実施

取得株式総数 286,000株 株取得総額 899,860,700円

取得期間 2023年5月11日~2023年6月23日

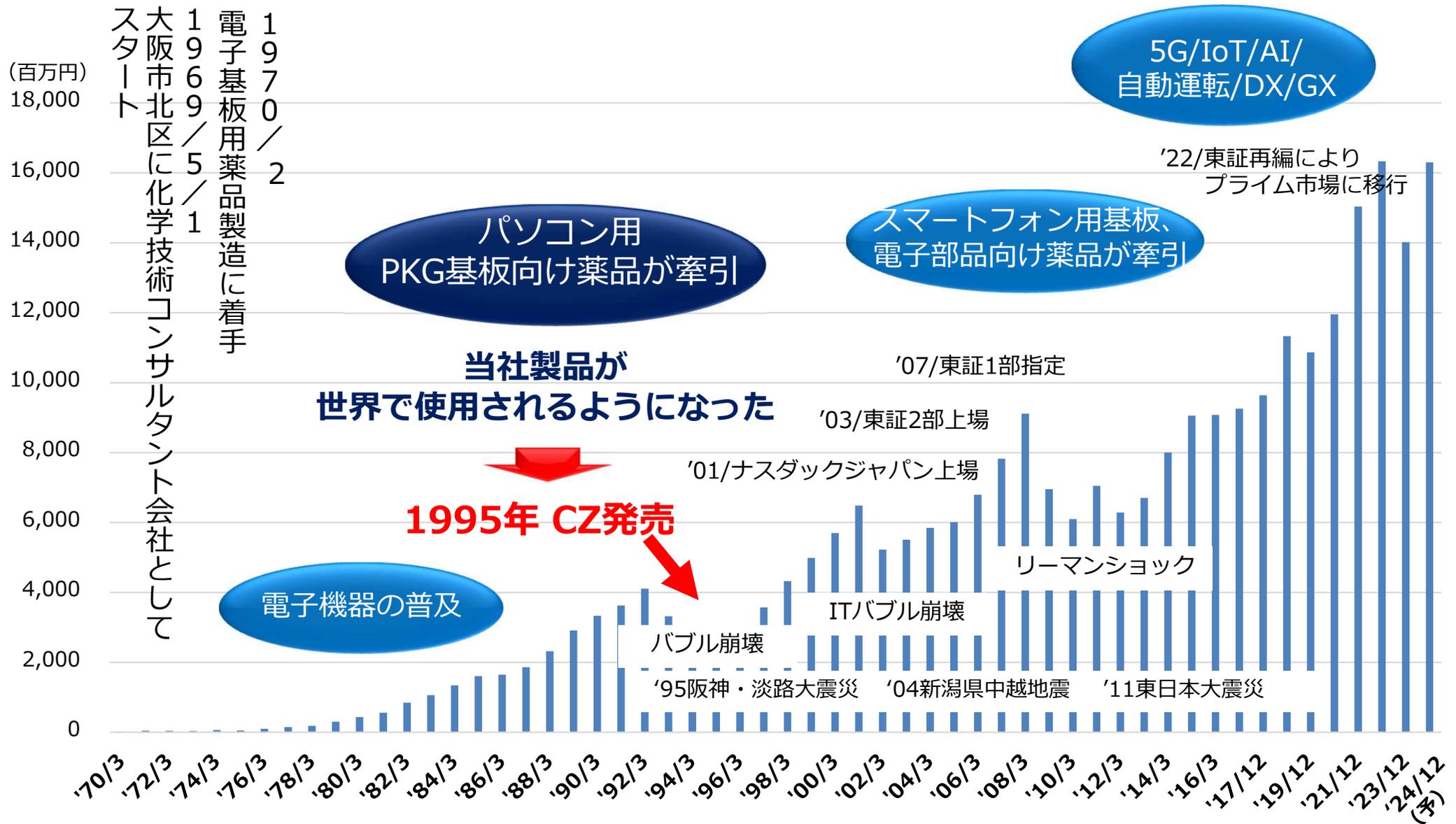


# 參考資料

(2023年12月31日現在)

社名	メック株式会社 MEC COMPANY LTD.
本社所在地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
設立年月日	1969（昭和44）年5月1日
主な業務内容	電子基板・部品製造用薬品の開発・製造販売 及び 機械装置、各種資材の販売
代表者	代表取締役社長 前田 和夫
資本金	5億9,414万2,400円
連結売上高	140億20百万円
上場市場	東証プライム市場（4971／化学セクター）
従業員数	連結454名、単体263名

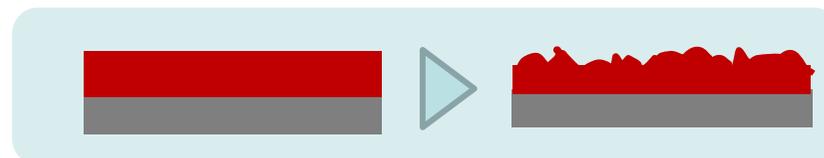
# 創業からの売上推移



## 界面価値創造

- **表面を粗化し、機械的に密着性を向上**

CZ、V-Bond



- **配線を形成する**

EXE

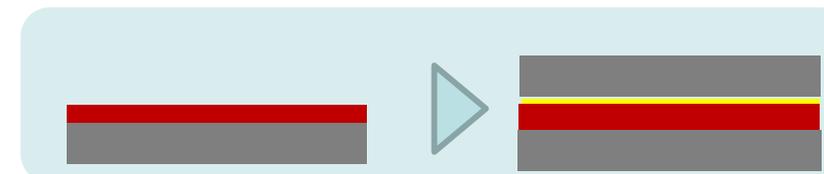


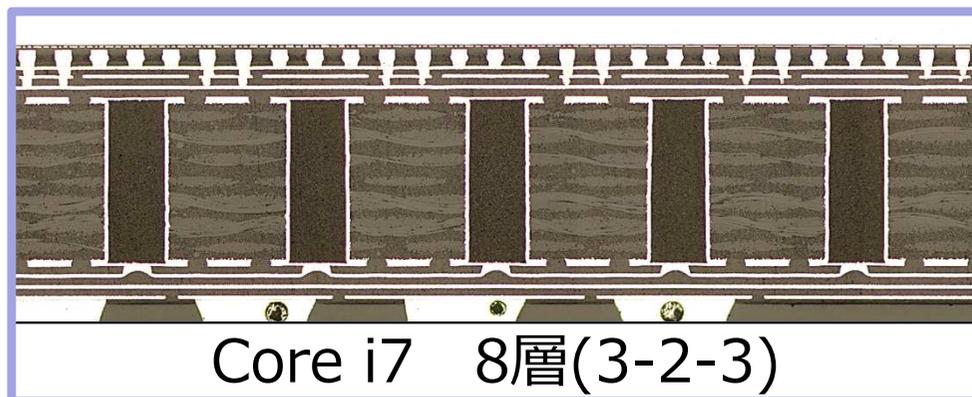
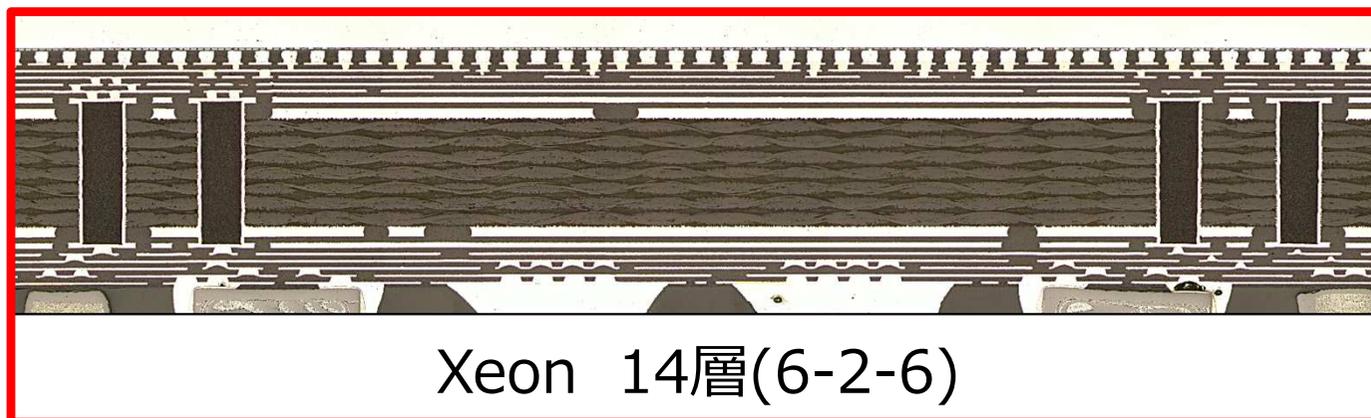
- **選択エッチング**

SF



- **表面を処理し、化学的に密着性を向上**





	PKG面積	層数
Xeon	27.44 cm <sup>2</sup>	14
Core i7	14.44 cm <sup>2</sup>	8
Ryzen	16.00 cm <sup>2</sup>	12

\*当社で入手、分解しました



尼崎工場（少量多品種）  
900 t /月



長岡工場（量産工場）  
2,750 t /月



メック台湾  
1,200 t /月



メック中国（蘇州）  
450 t /月



メック珠海  
1,000 t /月



メックヨーロッパ  
400 t /月



メックタイ  
500 t /月

# 界面価値創造

## Creating and Fostering Value at Various Interfaces

このプレゼンテーション資料には、2024年2月14日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。

